



Expediente: RTC2019-007217-2

Programa de financiación: RETOS COLABORACIÓN

Socios: Egatel, Star Electrónica y Aimen

De Enero 2020 a Diciembre 2022

En el seno del proyecto **PRIME-LAS** se desarrollará un proceso de impresión láser para la fabricación de PCB. En particular, se estudiarán dos tecnologías de impresión basadas en: transferencia láser y funcionalización láser.

Con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Agencia Estatal de Investigación.

